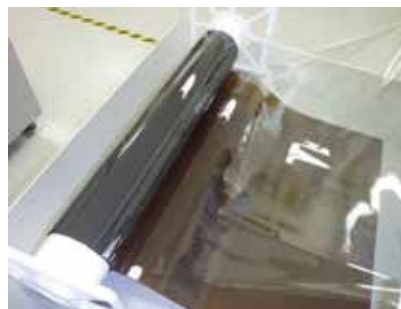


3 機能性ポリイミド

特徴

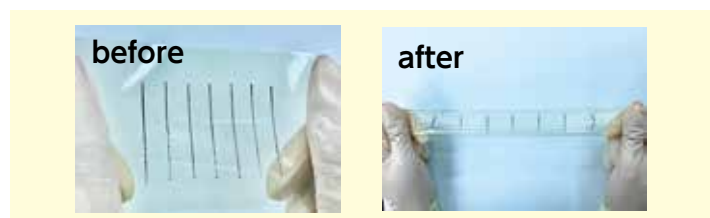
独自一次構造制御により各種機能を付与

ワニス、フィルム、CCLへの展開が可能



01 高伸度ポリイミドフィルム 開発品

用途	ストレッチャブル用途
	フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス基板
特徴	高伸度・低応力・高耐熱の達成



	高伸度ポリイミド	
	開発品①	開発品②
破断伸度 [%]	701	414
100% 伸長応力 [MPa]	2.8	5.3
耐熱性※ [°C]	140	>250

※DMA 弾性率が 1MPa 以上保持する温度

02 低誘電・低熱膨張性ポリイミド-FCCL 開発品

用途	高速通信
	高周波対応 フレキシブル銅張積層板 (FCCL)
特徴	低誘電・低熱膨張性の両立

F Series	New (開発品)
銅箔 ポリイミド F Series 銅箔	銅箔 ポリイミド New type 銅箔

		ESPANEX	
		F Series	開発品③※
誘電率	X-Y (SPDR) @10GHz	3.3	2.9
誘電正接	X-Y (SPDR) @10GHz	0.0031	0.0015
熱膨張率 [ppm/K]		18	18
ピール強度 [kN/m]		1.2	1.2
吸水率 [%] @25°C50%RH		0.8	0.2

※Cu=12μm, PI=75μm